

# 2023年3月期 決算説明資料

---

2023年5月19日



**内外テック株式会社**  
スタンダード3374

# 2023年3月期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

## 2023.3期 業績

■ 売上高	45,281百万円	(前期比 20.6%増)	↑
■ 営業利益	2,349百万円	(前期比 10.7%増)	↑

- 👉 計画を上回り、3期連続の増収増益  
⇒ 年度後半は減少が見られたが、半導体需要の高まりを背景に、半導体メーカーの設備投資が継続したことが主な要因
- 👉 上場来最高決算を更新

## トピックス

- 内外エレクトロニクス 江刺事業所の新設工事の完了  
⇒ 新設工事完了（2023年3月）  
⇒ 半導体市場の需要拡大に向けた生産キャパシティの拡大
- 内外テック 江刺開発センター開設（上記江刺事業所内）  
⇒ 2023年4月稼働  
⇒ 高真空/制御技術に対応する開発力強化のため

## 2024.3期 業績予想

■ 売上高	40,100百万円	(前期比 11.4%減)	↓
■ 営業利益	1,290百万円	(前期比 45.1%減)	↓↓

- 👉 スマートフォンやパソコン等の需要減少を背景にメモリーを中心とした在庫調整や対中輸出規制の影響等による一時的な半導体需要が減少
- 👉 投資による固定費や開発力強化のための先行費用増加から、営業利益も減少

## 3期連続の増収増益で、上場来最高決算を更新

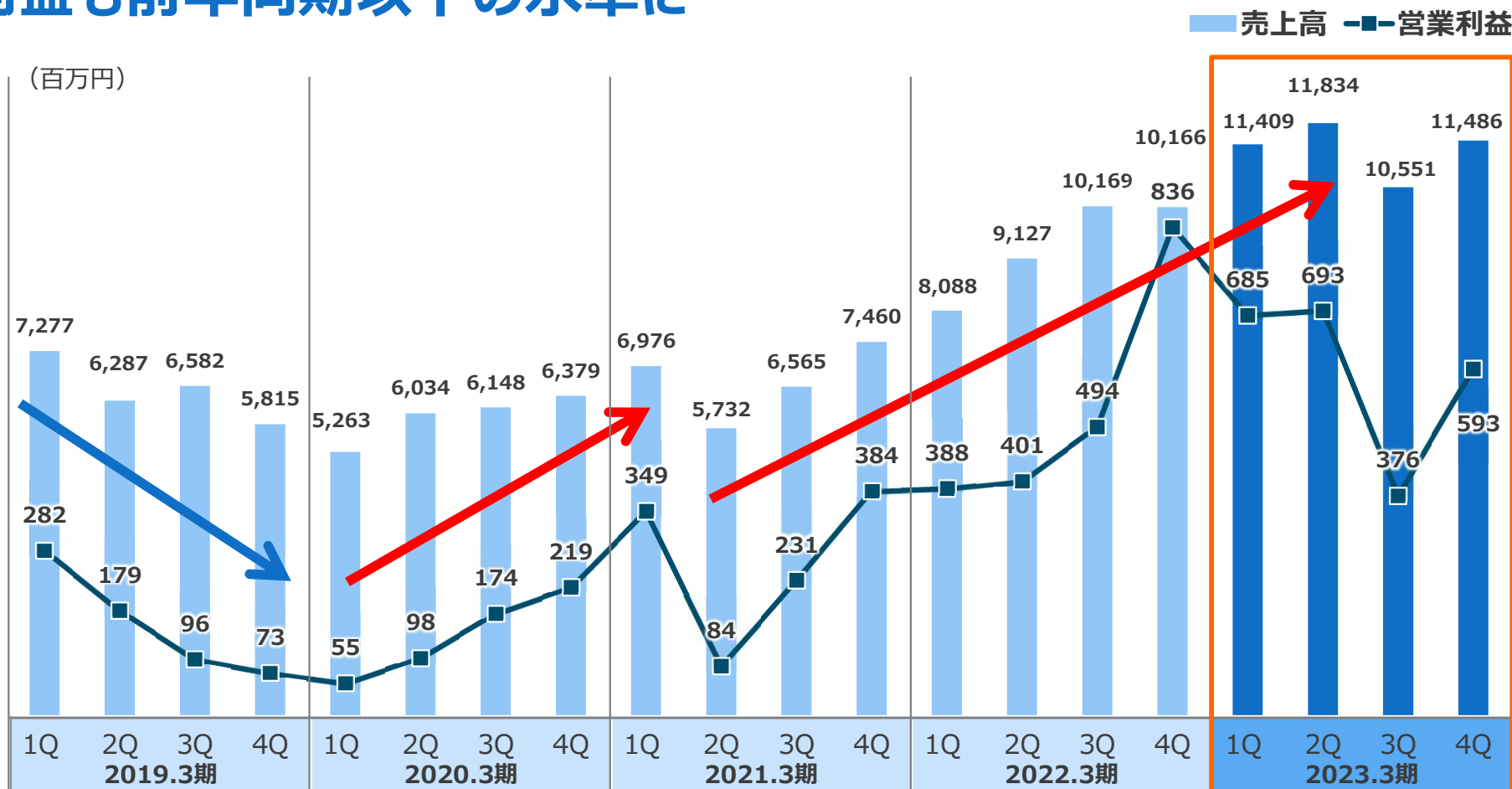
(百万円、%)

	2022.3期			2023.3期			予想 (5月13日公表)
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	
売上高	37,551	40.5	100.0	<b>45,281</b>	20.6	100.0	44,000
売上原価	33,039	40.2	88.0	<b>40,121</b>	21.4	88.6	-
販管費	2,390	12.4	6.4	<b>2,809</b>	17.6	6.2	-
営業利益	2,121	2.0倍	5.7	<b>2,349</b>	10.7	5.2	2,360
経常利益	2,107	2.0倍	5.6	<b>2,336</b>	10.8	5.2	2,330
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,541	2.1倍	4.1	<b>1,638</b>	6.3	3.6	1,580

- 売上高は、高速通信規格（5G）の普及やデータ通信量の増加によるデータセンター投資や車載向けをはじめとする幅広い用途での半導体需要の高まりを背景に、ロジックやメモリー、パワー半導体などの積極的な設備投資が継続し大幅な増収。
- 増収ながら、仕入コストやエネルギー価格の高騰等により、増益率は増収率を下回る。

# 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

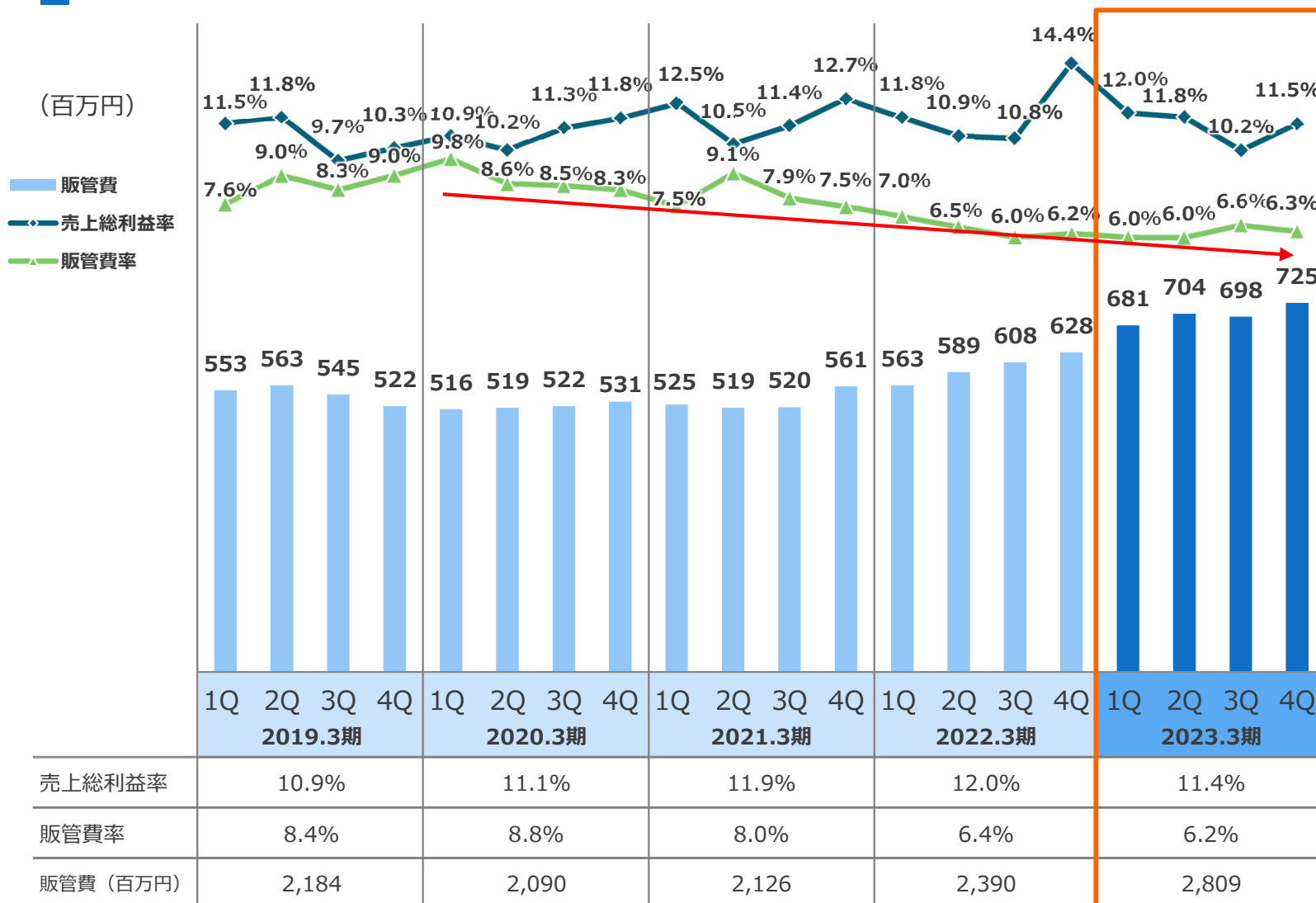
3Q以降は、メモリー需要バランス調整等から売上高は減少  
営業利益も前年同期以下の水準に



売上高	25,963	23,825	26,734	37,551	45,281
営業利益	632	547	1,049	2,121	2,349
営業利益率	2.4%	2.3%	3.9%	5.7%	5.2%

# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は2Qまでは前期を上回るが、3Q以降は前期を下回る  
 販管費率は2Qまでは前期を下回るが、3Q以降は前期を上回る



## 売上総利益率

- 部材確保及び前期の増員人員の習熟度が向上し生産性が改善
- 3Qは売上減少により、受託製造事業に係る労務費を中心とした固定費率が増加したことにより低下
- 4Qは仕入先からの販売報奨金により改善

## 販管費・販管費率

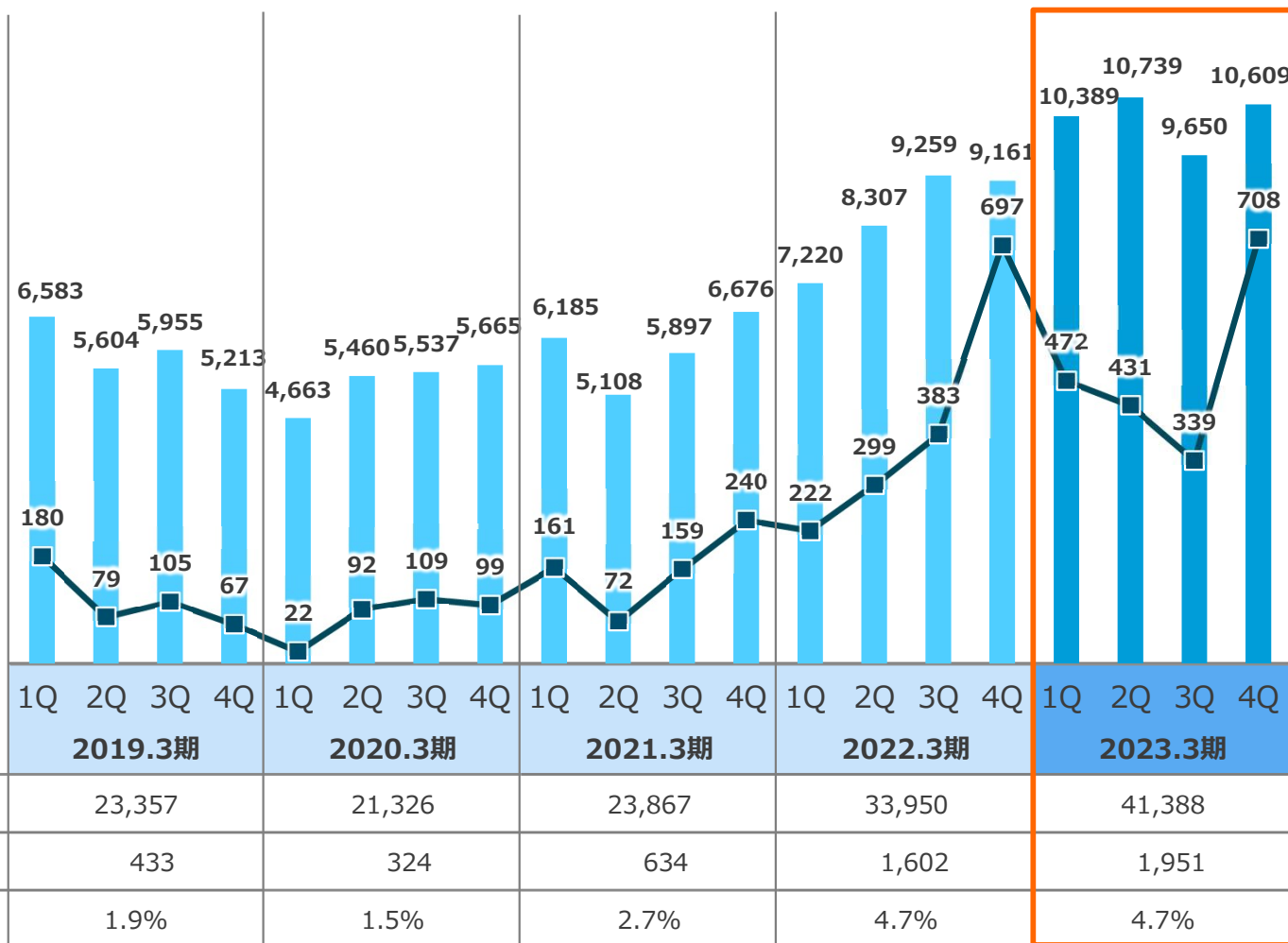
- 販管費は、取扱量の増加に伴い人件費・物流費を中心に増加。
- 販管費は増加するも増収効果により販管費率は低下傾向。

## 上場来最高の売上高を更新

(百万円)

■ セグメント売上高

■ セグメント利益



**セグメント売上高 41,388百万円**  
(前期比 21.9% ↑)

- 5Gの普及やデータセンター向け、また自動運転など半導体需要の活況を受けて、増減はあるものの安定した売上が継続。

**セグメント利益 1,951百万円**  
(前期比 21.7% ↑)

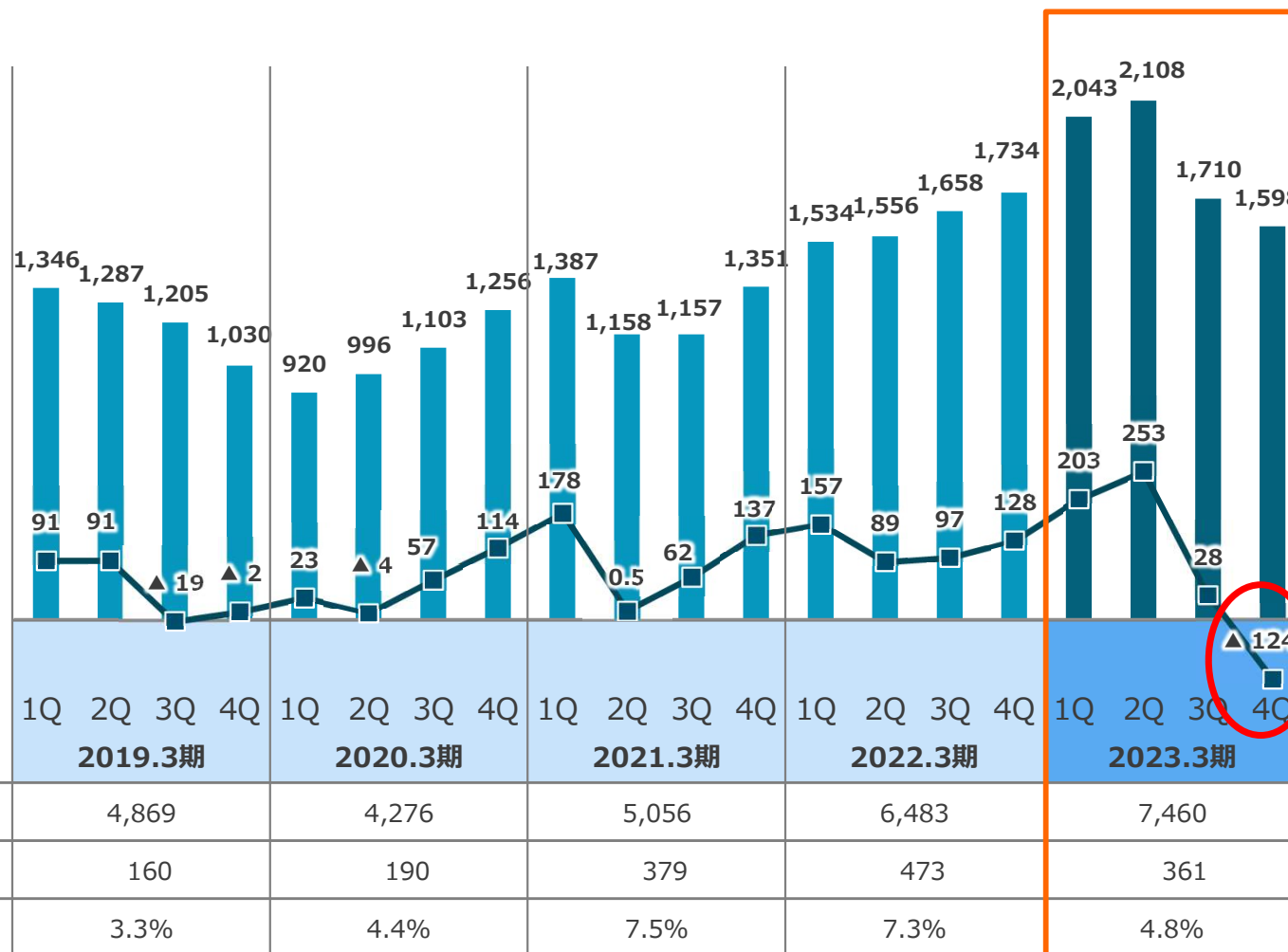
- 4Qの特別要因を除き、売上増加による安定した収益を確保。
- 仕入先からの販売報奨金が4Qに寄与。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

## 3Q以降、売上・利益ともに低下

(百万円)

■ セグメント売上高  
■ セグメント利益



セグメント売上高 **7,460**百万円  
(前期比 **15.1%** ↑)

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて主要顧客の増産が続き、前期実施の製造増員により生産量が増加し、上期売上増加に寄与。
- 下期は調整局面により減産に。

セグメント利益 **361**百万円  
(前期比 **▲23.7%** ↓)

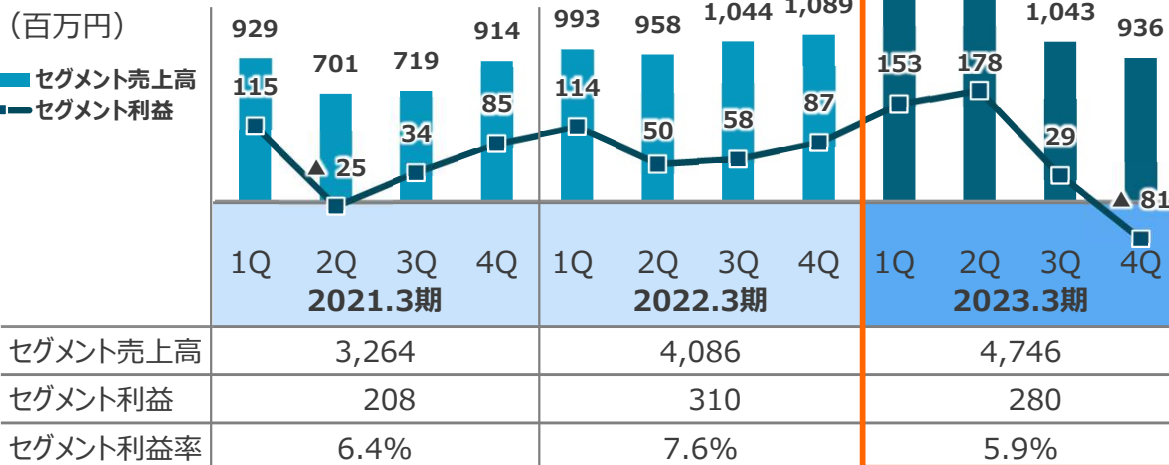
- 上期は、前期の増員人員の習熟度の向上により生産性が改善し利益に寄与。
- 下期は、売上減少に対し、回復立ち上がりを踏まえた労務費の維持から利益が減少
- 4Qは、退職給付会計の債務計算の変更により、155百万円の利益減少要因に。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。



# セグメント情報：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション



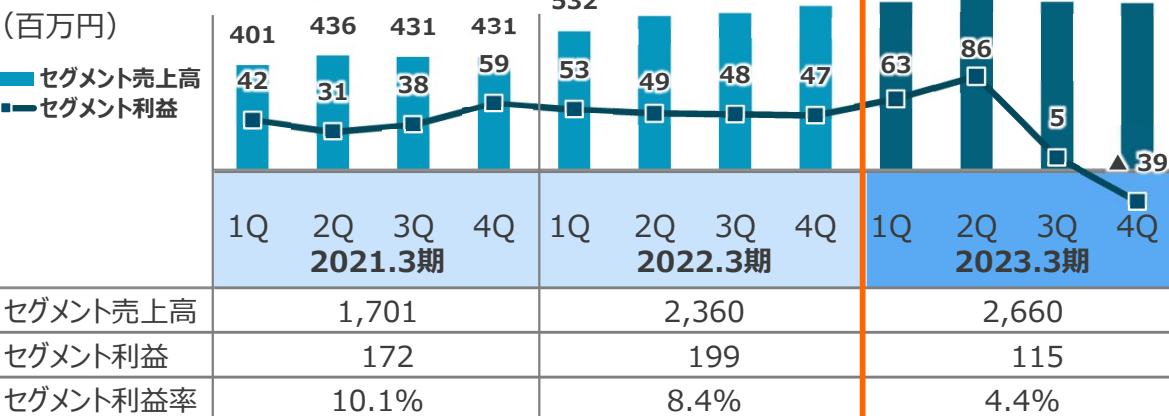
### 【事業内容】

顧客からの受託組立

### 【当期の概況】

- 上期は半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主要顧客の増産が続き受注が増加するも、下期は調整局面により減産に。
- コスト面では、上期は前期増員を行った製造員の習熟度向上及び部材確保による生産性が改善が寄与したものの、下期は売上減少による労務費等の固定費負担増が利益を圧迫。

## ◆ フィールド・ソリューション



### 【事業内容】

保守・メンテナンスサービス

### 【当期の概況】

- 前期増員や保守エリア拡大による生産量増加が売上に貢献。また、半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、装置立上受注の増加により増収。
- 新規受注に向けての人員増や教育等の先行費用が増加し利益率は低下。

## ◆ テクニカル・ソリューション

(百万円)

		2021.3期				2022.3期				2023.3期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
四半期ベース	売上高	57	20	6	5	7	5	9	12	3	7	21	20
	利益	21	▲5	▲9	▲7	▲11	▲11	▲9	▲5	▲14	▲10	▲6	▲3
通期	売上高	90				36				52			
	利益	▲1				▲36				▲35			

### 【事業内容と目的】

自社製品開発・技術開発

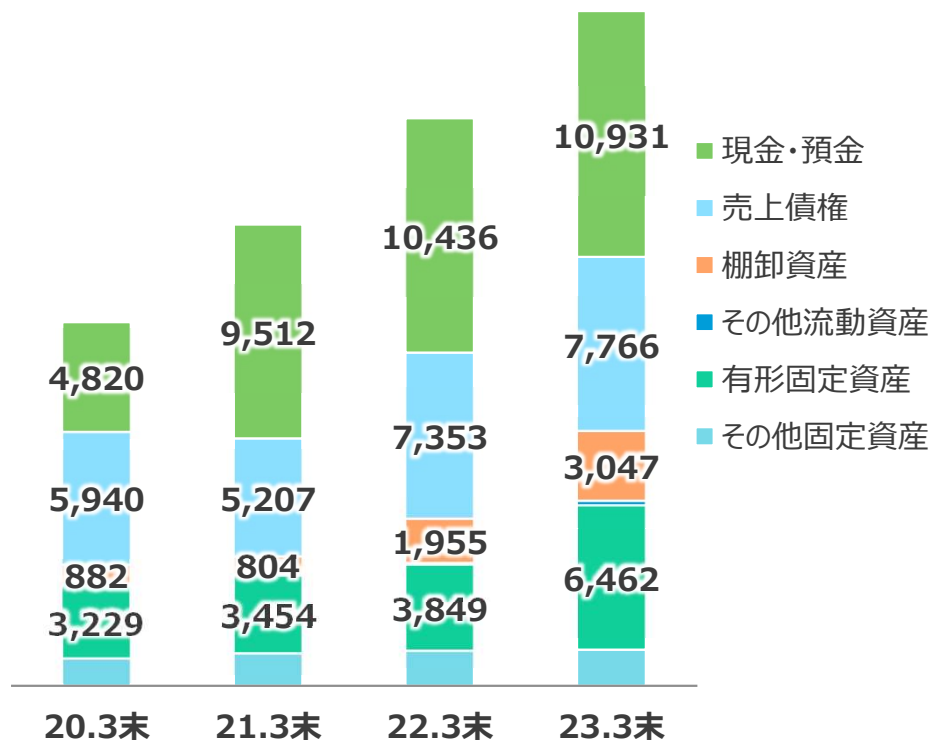
### 【当期の概況】

- 技術研修等、製品開発に必要な技術の習得への投資を継続中。中長期的な成長戦略の中核へ。

# 貸借対照表

## ◆ 資産

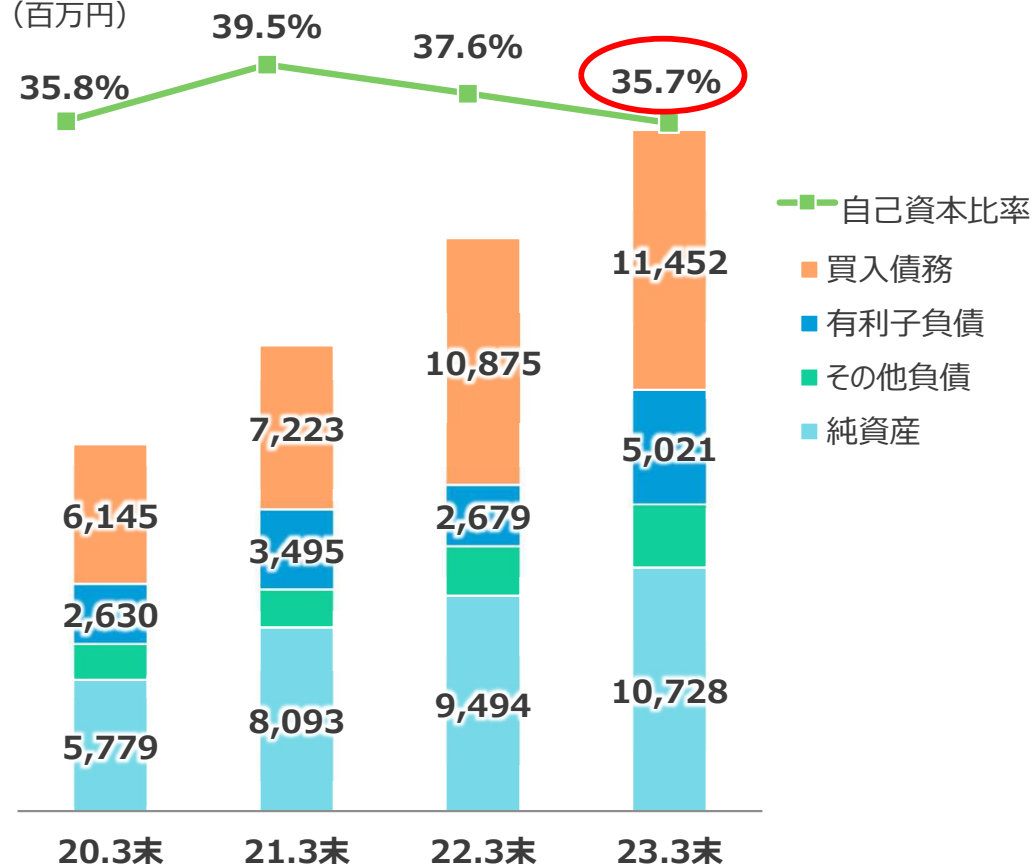
(百万円)



- 売上増及び借入により現預金は、4億95百万円増加。
- 部材確保のための先行仕入により、棚卸資産は13億4百万円の増加。
- 江刺事業所新設により建物及び構築物が25億3百万円増加し、有形固定資産は64億62百万円に。

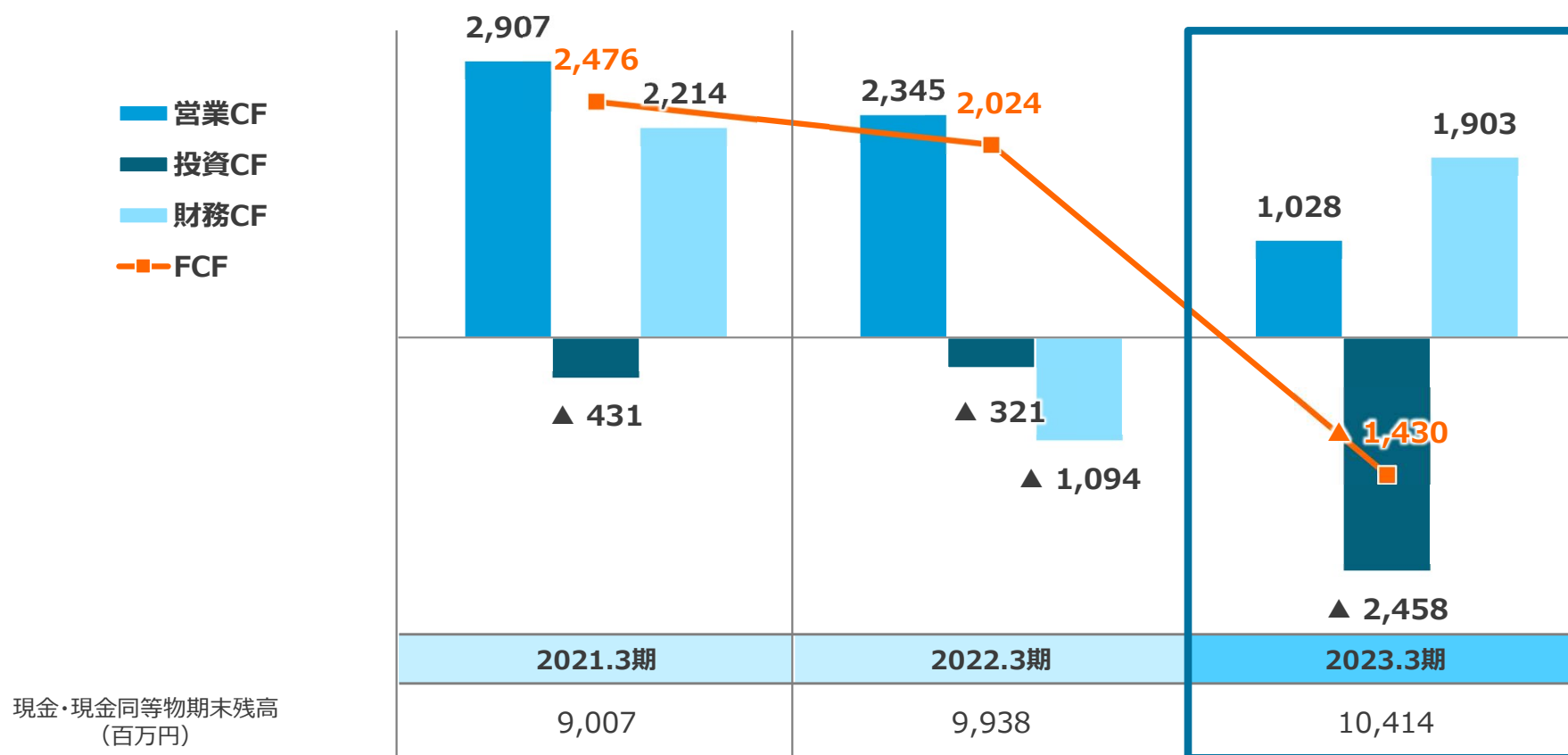
## ◆ 負債・純資産

(百万円)



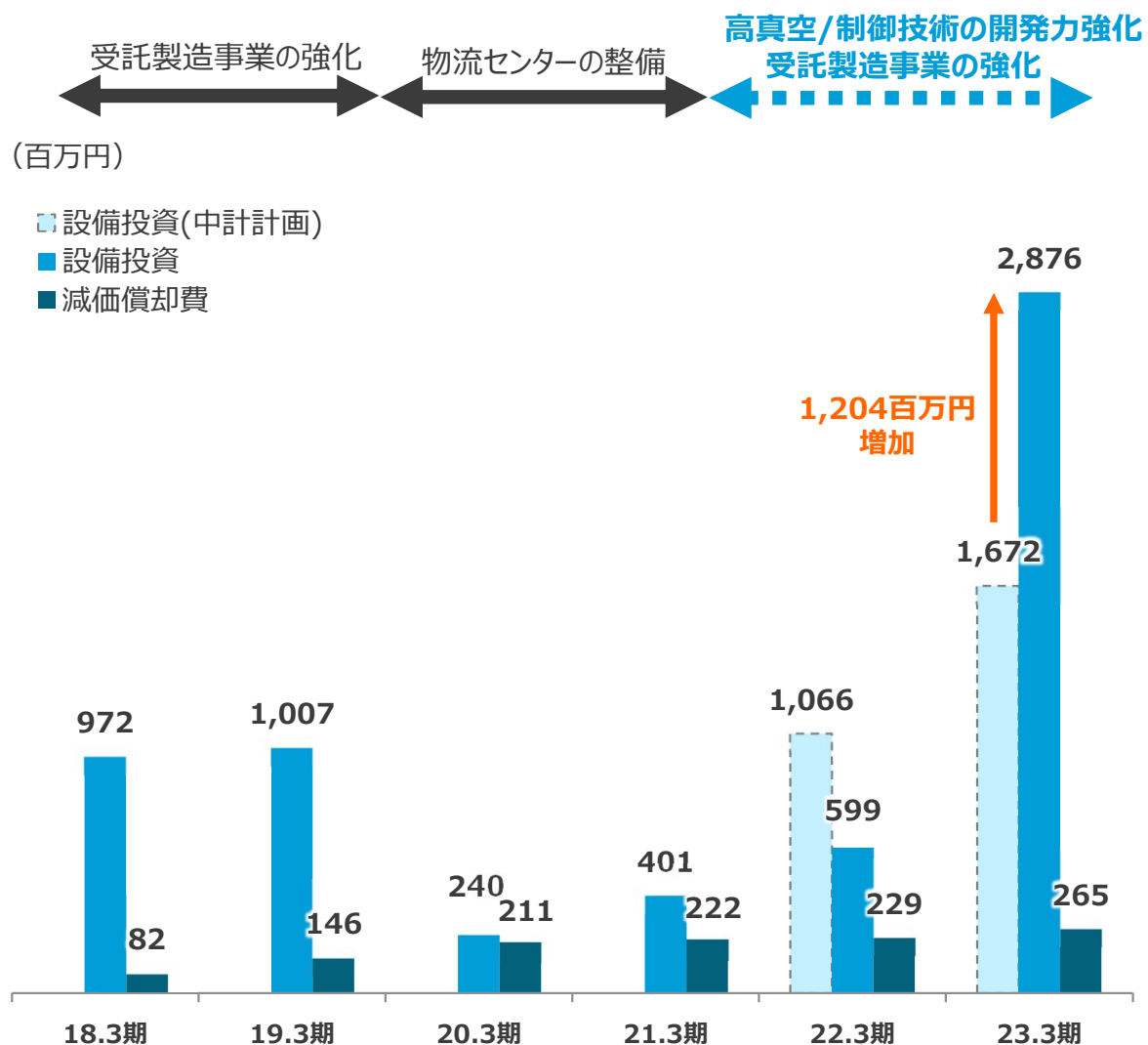
- 売上増及び部材確保のための先行仕入により、買入債務が5億77百万円増加。
- 有利子負債は、運転資金の他、江刺事業所建設に係る設備投資の借入により23億41百万円増加。
- 純資産は利益の積み上げにより増加するも、売上増加に伴う買入債務の増加、設備投資に伴う有利子負債の増加等により自己資本比率は低下。

## 江刺事業所新設工事の支出によるフリーキャッシュフローのマイナスを 財務キャッシュフローでカバー 現金及び現金同等物残高は、4億76百万円増加し104億円に



- 主に棚卸資産の増加により、営業キャッシュフローは10億28百万円に減少
- 将来の成長に向けた江刺事業所の設備投資の実施により、投資キャッシュフローは▲24億58百万円
- 運転資金のほか設備投資の借入を行ったことで、財務キャッシュフローは19億3百万円に拡大

## 今後10年の開発力強化のため、市場動向を踏まえ、半導体製造装置に係る開発に対する追加設備を実施



### 主要設備投資の目的

1. 販売事業の倉庫・物流体制強化
2. 受託製造事業の生産能力拡大
3. 仕入先メーカーとの協業による開発体制の強化

#### ● 22.3期

- ・内外テック 宮城物流センター  
グループ物流の統合 1.4億円
- ・内外エレクトロニクス 仙台事業所  
クリーンルーム改築 3.2億円

#### ● 23.3期

- ・内外エレクトロニクス 江刺事業所  
工場新設 26.6億円
- ・内外テック  
内外エレクトロニクス江刺事業所内に  
自社開発のための開発センターを新設

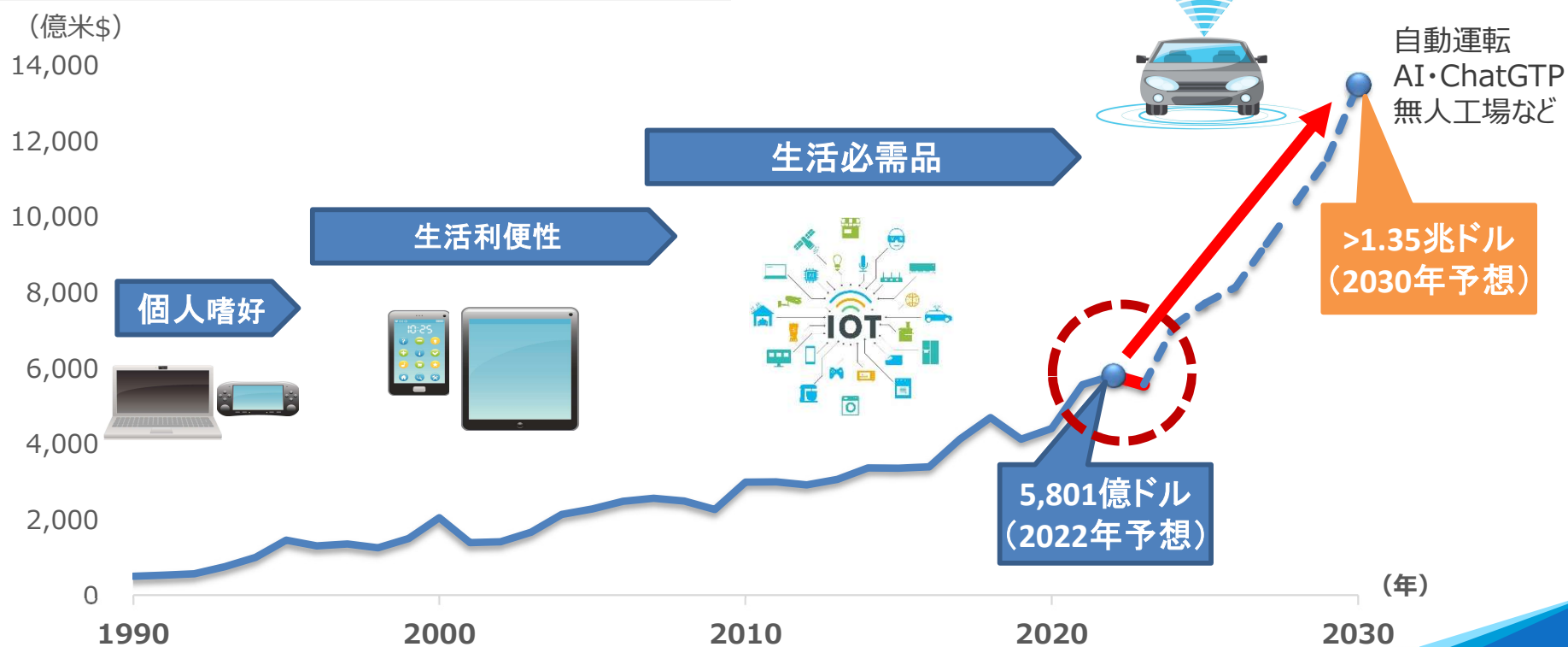
👉 当社グループの生産能力は大きく向上。開発力は直ぐに収益に結びつかないが、今後10年の中で大きな成果を見込む。

# 2024年3月期 連結業績予想

## 半導体需要は中長期的に拡大傾向 今後の成長を支える真空／制御技術に対応する技術開発力を構築

### 日本における中期の環境変化

- JASM（熊本県）24年稼働予定
- ラピダス（北海道千歳市）北海道新工場建設
- 日本政府の半導体・デジタル産業戦略による助成金
- データセンター集積地等立地促進基盤の整備

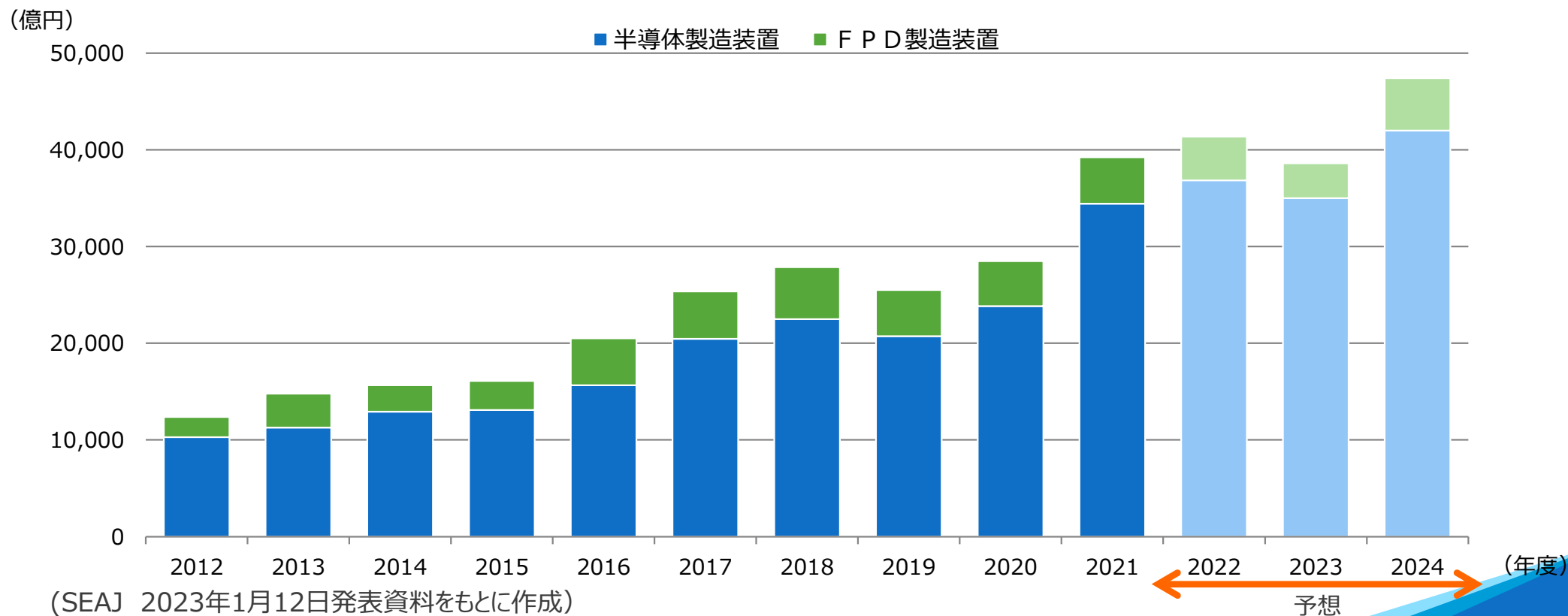


(世界半導体市場統計(WSTS)、International Business Strategiesの資料をもとに当社にて作成)

## 半導体製造装置を取り巻く環境は一時的な減速懸念もあるが、 中期的な拡大傾向は続く

- 中長期的には、デジタル・トランスフォーメーション（D X）やグリーン・トランスフォーメーション（G X）需要は不変
- 各国の半導体投資への支援体制も含め、従来のパソコンやスマートフォンに加え、5 G、I o T、A I、データセンター、自動車のE V化や自動運転等が引き続き半導体製造装置の需要拡大を牽引

### 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



下期からの回復を見込むも、メモリーを中心とした一時的な半導体需要の減少を受けて設備投資の先送り等から減収を予想。  
エネルギー費用のほか投資や人員・教育等先行費用の固定費増により減益予想。

(百万円、%)

	2023.3期			2024.3期						
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	2Q累計	前年同期比	中計	中計比
売上高	45,281	20.6	100.0	40,100	△11.4	100.0	18,700	△19.5	41,500	△3.4
営業利益	2,349	10.7	5.2	1,290	△45.1	3.2	145	△89.5	2,655	△51.4
経常利益	2,336	10.8	5.2	1,260	△46.1	3.1	130	△90.5	—	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,638	6.3	3.6	840	△48.7	2.1	62	△93.2	—	—
設備投資額	2,876	5倍	—	—	—	—	—	—	—	—
減価償却費	265	15.4	—	283	6.9	—	—	—	—	—

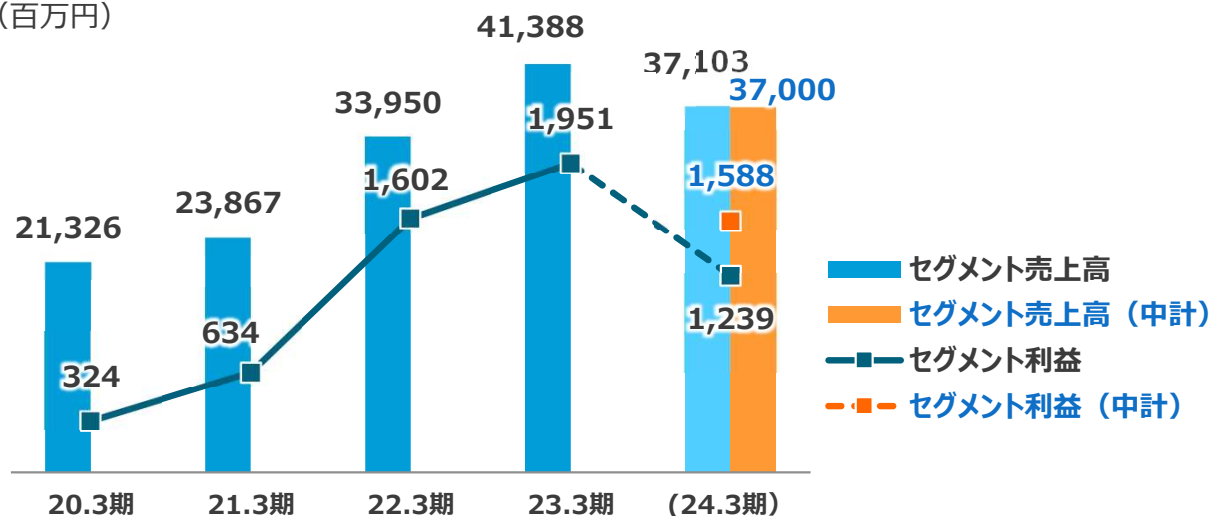
※ 2024年3月期の各段階利益には、2023年3月期に計上しました仕入先からの販売報奨金を一定の範囲で見積もっております。



# セグメント予想

## ◆ 販売事業

(百万円)



### セグメント売上高

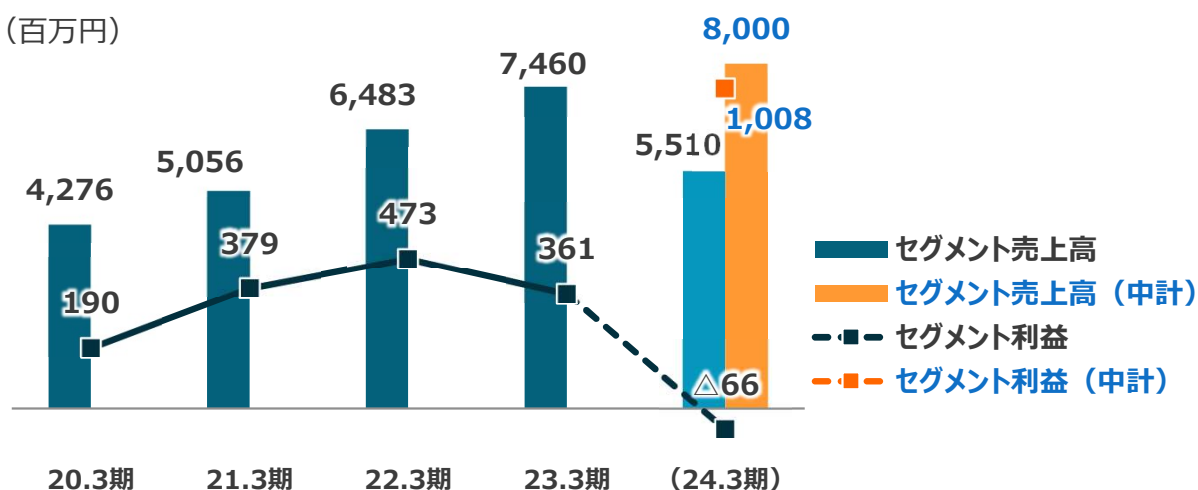
- 一時的な半導体需要減少を受けて設備投資の先送り等により減収予想

### セグメント利益

- 売上高の減少のほか、今後の売上増加を踏まえた物流改革費用（約50百万円）、10年後を踏まえた江刺開発センター稼働に伴う技術者の増員等の研究開発費用（約400百万円）の増加により減益を予想

## ◆ 受託製造事業

(百万円)



### セグメント売上高

- 主要顧客からの受注減少により減収予想

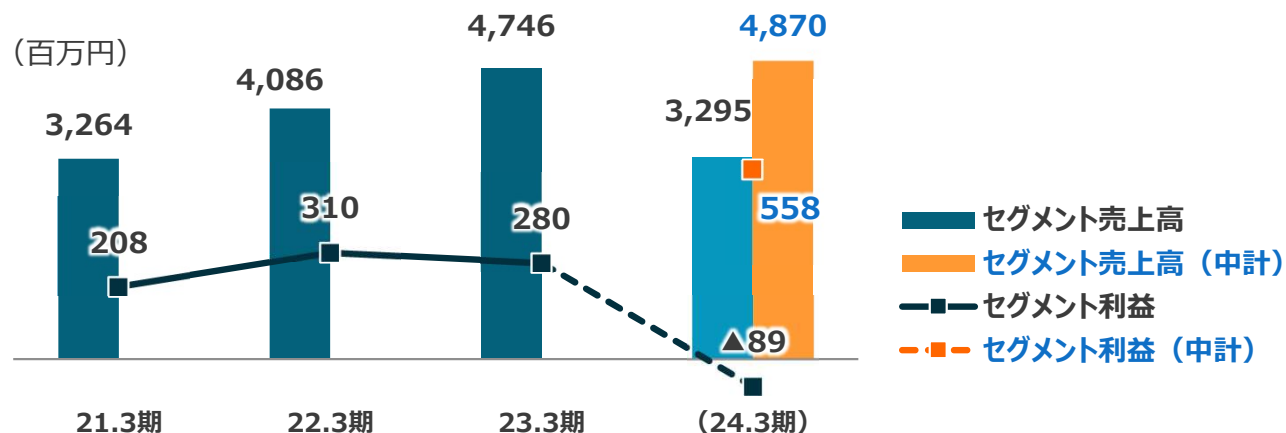
### セグメント利益

- 売上高減少に加え、今後の回復に備えた工場人員の維持費用、江刺事業所取得に伴う不動産取得税を含む租税公課等の一時的費用、減価償却費や電力費の増加が利益を圧迫し、赤字となる見込み

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

# セグメント予想：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション



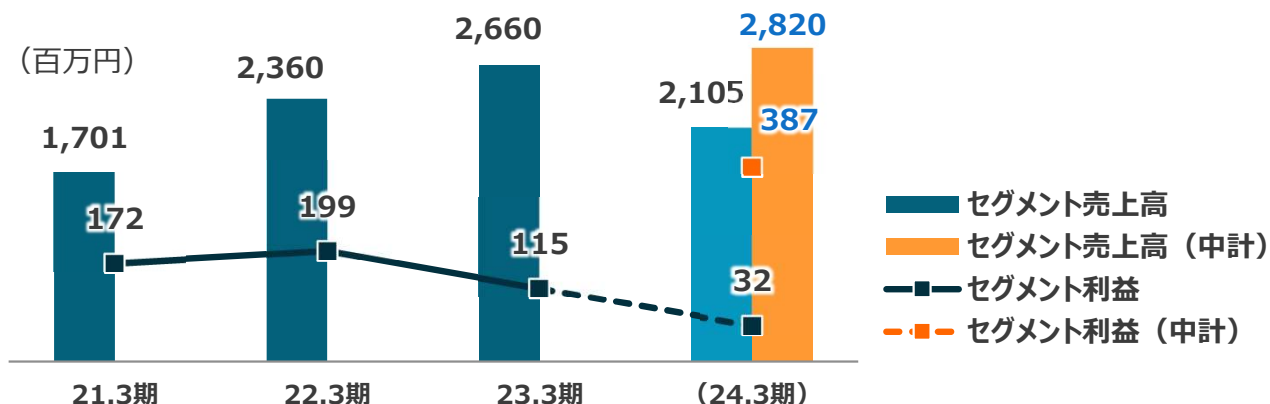
### セグメント売上高

- 半導体市場の調整局面により、顧客からの受注減少により減収予想

### セグメント利益

- 売上減少、電気料金等の電力費や物流費高騰による原価、次の立ち上げに向けた人員確保等による固定費増により減益予想

## ◆ フィールド・ソリューション



### セグメント売上高

- 半導体市場の調整局面により、半導体メーカーの減産による保守メンテの減少や新規設備投資の先送り等による立上作業の減少により減収予想

### セグメント利益

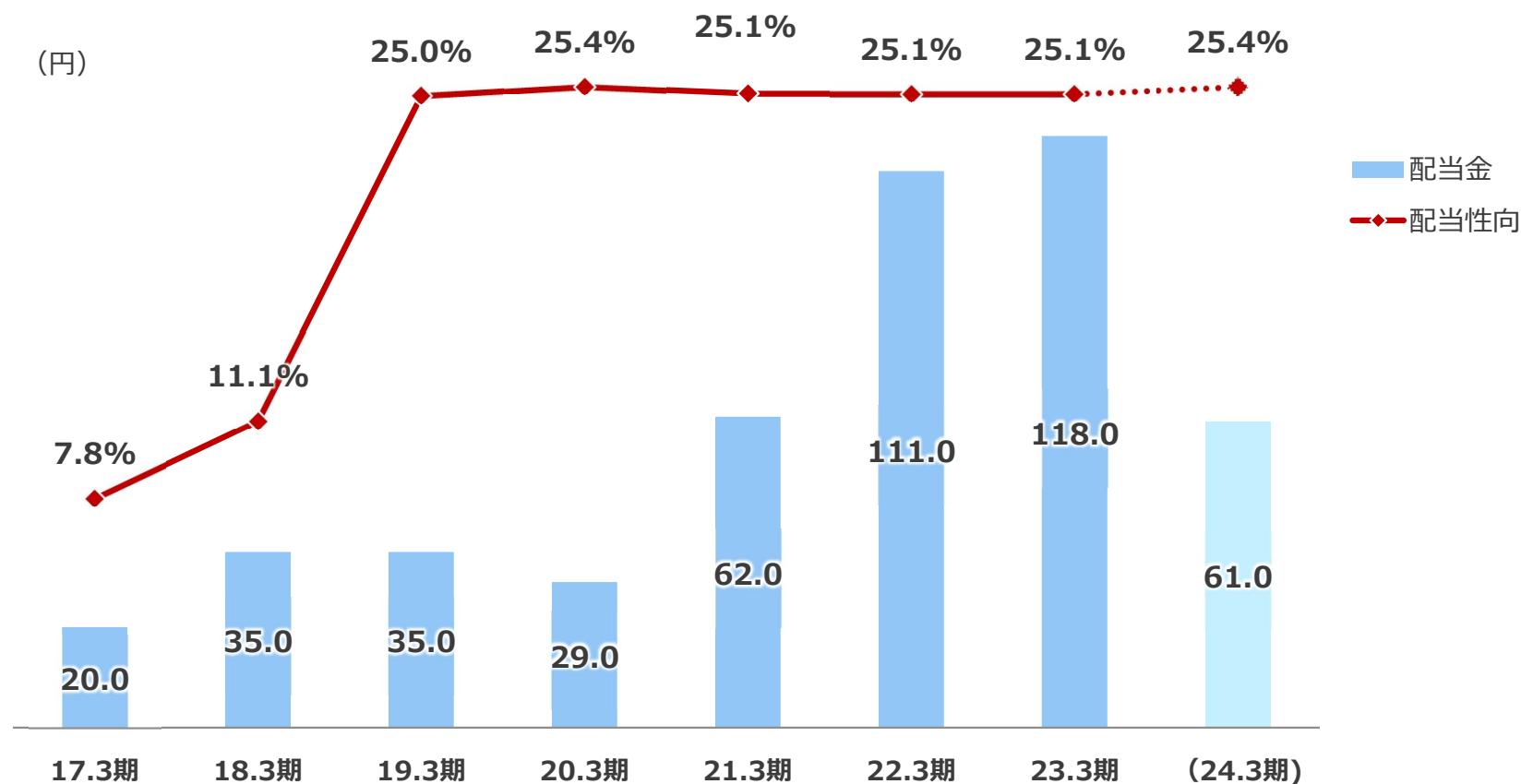
- 売上減少のため変動費の低減を図るも、新規顧客獲得に向けた人員確保や教育等の先行費用の増加により減益予想

## ◆ テクニカル・ソリューション

	21.3期	22.3期	23.3期	(24.3期)	
	実績	実績	実績	計画	中計
セグメント売上高	90	36	52	111	310
セグメント利益	▲1	▲36	▲35	▲8	62

- 今後の成長を見据えた製品の受注と製造技術やスキルの向上に注力

## 連結配当性向25%程度を基準



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

# サステナビリティ目標の進捗状況

## 23.3期のKPIは70.6%（12/17項目）の達成 教育機会の付与等を中心とした人的資本に今後も注力

マテリアリティ	カテゴリー	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	単位	23.3期				24.3期
					目標	実績	目標比	評価	目標
顧客対応力	商社機能	サプライチェーンの最適化	物流コストの削減率（21/3期比）	%	-10	-14.1	-4.1	○	-15
		顧客情報の情報セキュリティ	情報セキュリティに関するクレーム件数	件	0	0	0	○	0
生産性向上	製造機能	製造部門の効率化	製品品質クレーム数の削減（前年対比）	%	-10	-2.3	7.7	▲	-10
		高真空分野の製品量産	量産移行件数（21/3期比）	件	10	9	-1	▲	15
保守・メンテナンス	保守・メンテナンス機能	中古機部門の技術革新	修理リードタイムの低減（21/3期比）	%	-10	-12	-2	○	-10
		リペア部門の一元管理化	保守管理リードタイムの低減（21/3期比）	%	-5	-3	2	▲	-5
製品開発力	R&D機能	高真空分野の製品開発	製品開発数	件	0	0	0	○	1
経営基盤	経営管理	環境コンプライアンス	環境マネジメント（ISO14001）の維持 審査合格	認証	認証	認証	0	○	認証
		有害物質管理	有害物質含有調査率（回答率）	%	100	100	0	○	100
		CO2 排出量削減効果	CO2 排出量削減	%	—	44.6	—	—	—
		労働安全衛生	重大事故（休業災害）発生件数	件	0	0	0	○	0
		中核人材における多様性	女性管理者比率（グループ）	%	6	6.8	0.8	○	7
		教育機会の付与	一人あたりの研修時間	時間	20	19.6	-0.4	▲	20
		コンプライアンス・腐敗防止	重大なコンプライアンス違反（訴訟）件数	件	0	0	0	○	0
		責任ある鉱物調達	紛争鉱物調査率（回答率）	%	100	100	0	○	100
		DXの推進・情報管理	デジタル化による業務効率向上（21/3期比）	%	20	20	0	○	30
		責任ある情報管理体制	機密情報の流出件数	件	0	0	0	○	0
		継続的成長を実現する財務基盤の強化	自己資本比率	%	38.6	35.7	-2.9	▲	40.9

※ ○ = 達成 ▲ = 未達成

## 高真空／制御技術に対応する

### 1. 開発力強化

新しい事業領域へ積極的にチャレンジし、顧客視点で技術的な提案をし問題解決をすることで、持続的な成長につなげていく

### 2. 今後更なる需要増加が見込まれる半導体製造装置の増産対応

切れ目のない  
持続的成長

新しい付加価値提供

- お客様近隣立地の工場
- 開発力・設計力の提供

事業領域の拡大

基礎事業の強化

- 内外エレクトロニクス株式会社 江刺事業所 新設 2022年12月稼働
- 内外テック株式会社 江刺開発センター 新設 2023年 3月竣工



江刺事業所 クリーンルーム

土地面積：8,666㎡ 延床面積：6,898㎡ クリーンルーム：1,089㎡

# **(参考資料) 会社概要**

# 会社概要

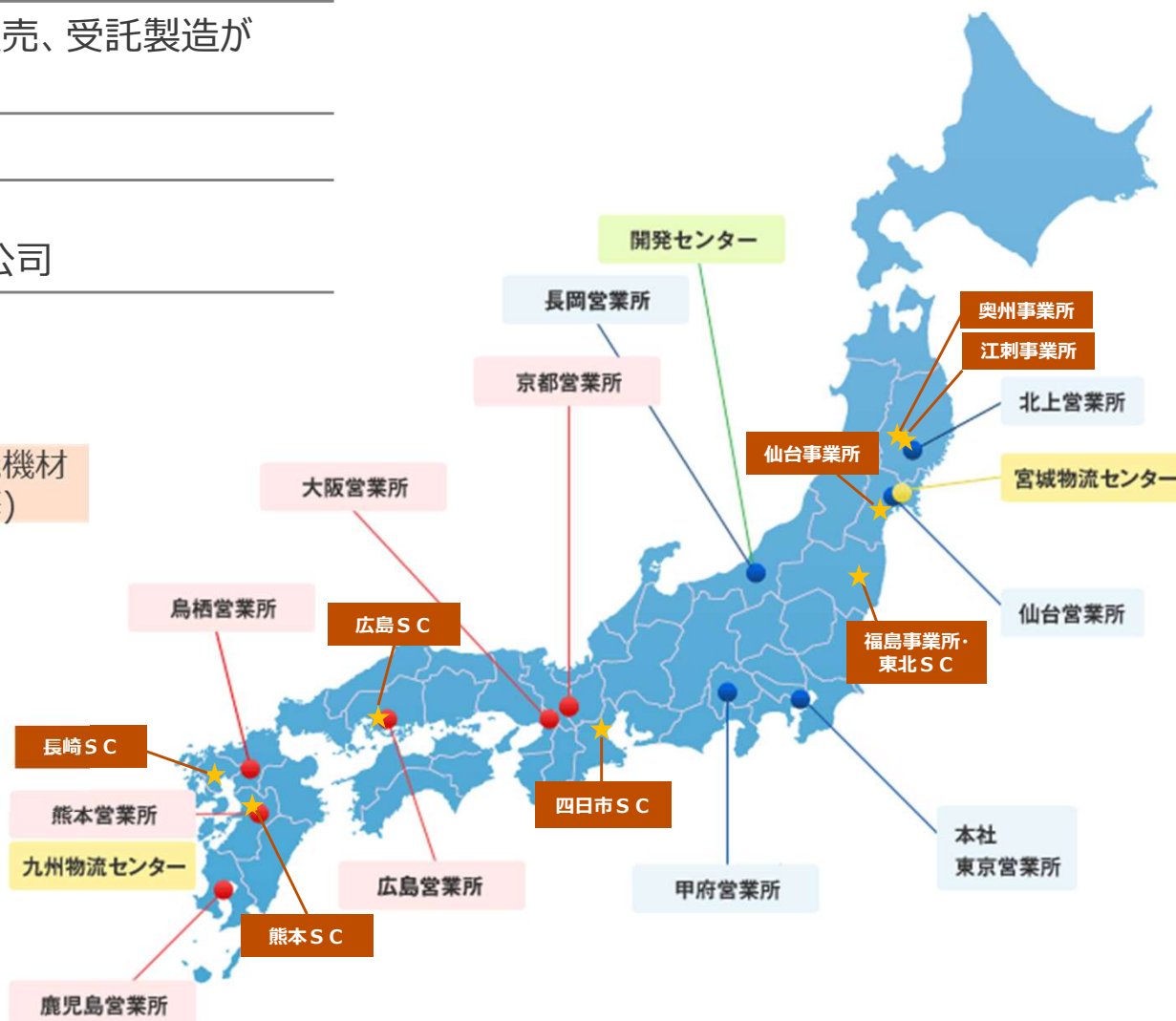
所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 690名 (2023年3月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○  
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

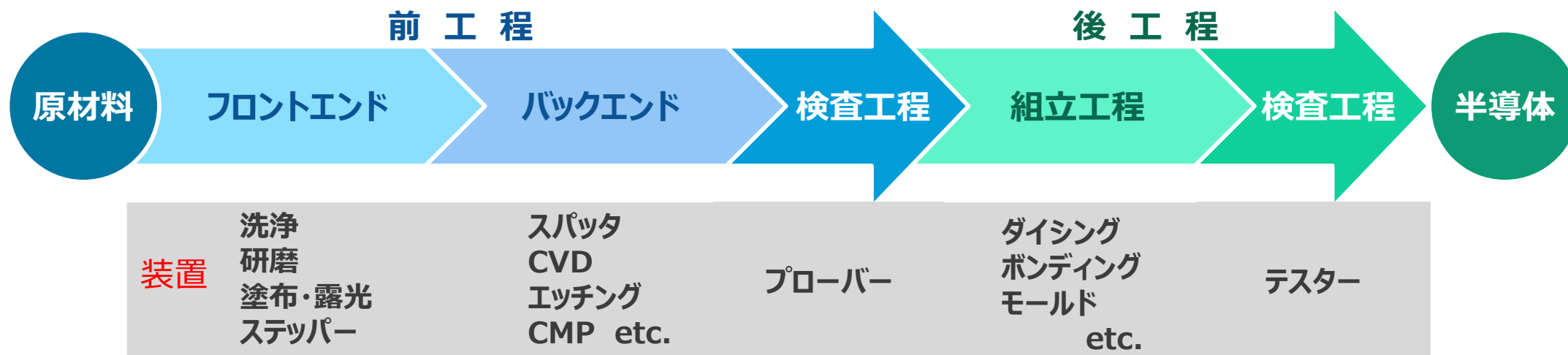
中国・上海



納宜伽機材  
(上海)



## 半導体製造工程概要



中長期的には、5G対応のスマートフォンや基地局や自動車の自動運転向けなど半導体の需要増を背景に、前工程の設備投資は拡大が見込まれる。

内外テック  
技術提案商社

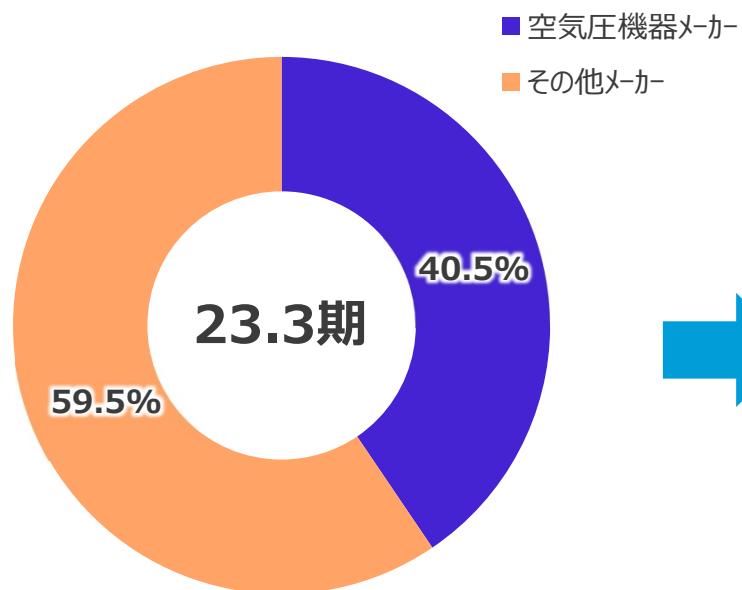
+

内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー

＝ モノづくりができるメーカー商社

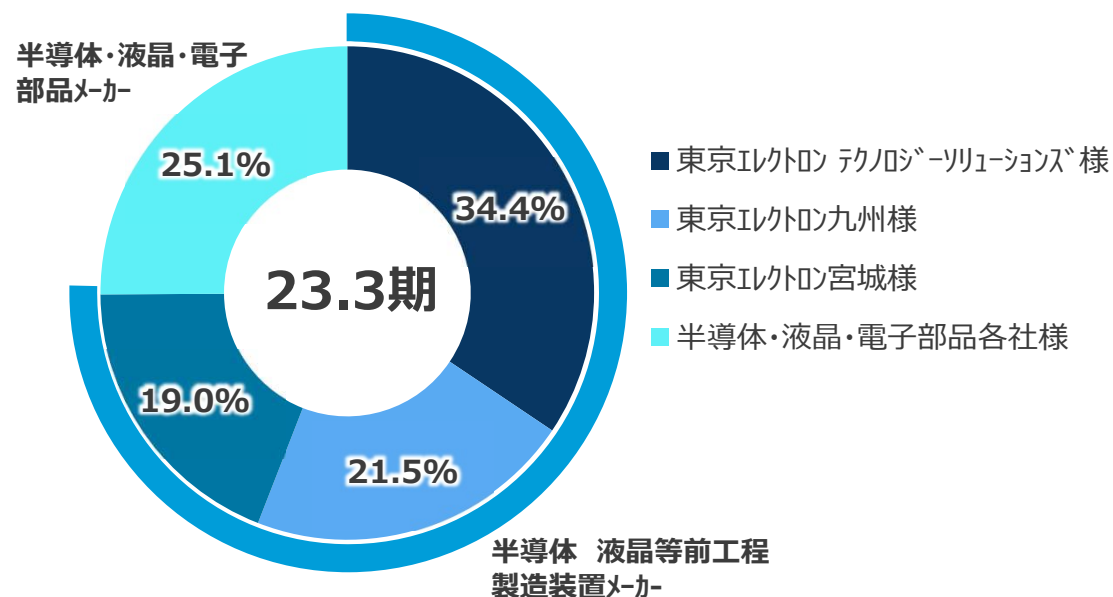


## 【仕入先】



## 【販売先】

東京エレクトロン様グループで7割強



### 内外テック 仕入先・販売先

- 仕入先メーカー数 約1500社
- 得意先数 約 940社
- 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造

年間取扱いアイテム 約54,000件

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社